

杭州士兰微电子股份有限公司

关于收到政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和控股子公司杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）以及其它第三方共同承担了“面向移动终端和物联网的智能传感器产品制造与封装一体化集成技术”项目（以下简称“该项目”，具体内容详见公司于 2013 年 1 月 22 日披露的《关于公司承担国家科技重大专项获批的公告》，公告编号临 2013-002 号）。该项目已通过综合绩效评价，本公司与士兰集成将合计获得中央财政资金项目后补助款 3,269 万元，其中本公司将获得的后补助金额为 1,037 万元，士兰集成将获得的后补助金额为 2,232 万元。

公司已于 2019 年 9 月 20 日收到上海市科学技术委员会因该项目转拨付的补助资金 1,211 万元（其中本公司获得的补助金额为 384 万元，士兰集成获得的补助金额为 827 万元）。该项目剩余的 2,058 万元后补助资金尚未拨付，公司将在收到后及时履行信息披露义务。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定认为，上述政府补助资金同时包含与资产相关部分和与收益相关部分。上述政府补助资金将根据实际情况，计入当期或递延进入各期的损益。最终的会计处理以及对公司 2019 年度利润产生的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日